

证券代码：301297

证券简称：富乐德

安徽富乐德科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与富乐德（301297）2025年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月12日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 贺贤汉 董事兼总经理 王哲 独立董事 黄继章 董事会秘书 颜华 财务负责人 陈秋芳 保荐代表人 胡宇翔
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 2025 年国内半导体设备国产化率提升、功率半导体受益新能源政策，公司“洗净服务 + 半导体材料”双主业如何匹配政策导向？</p> <p>答：在洗净服务领域：支撑设备国产化，保障产业链自主可控</p> <p>2025年，国内半导体设备国产化率持续提升，晶圆厂扩产步伐加快。公司的精密洗净服务作为晶圆制造过程中不可或缺的配套环节，为国产设备厂商和晶圆厂提供稳定、高效的洗净服务，公司有</p>

效保障了国产设备的稳定运行与良率提升，成为半导体设备国产化进程中重要的“支撑者”和“守护者”，积极响应了国家关于提升产业链自主可控能力的政策导向。

在半导体材料领域：填补高端空白，赋能新能源战略

公司通过子公司富乐华布局的覆铜陶瓷载板（DCB/AMB/DPC）等半导体材料，是功率半导体模块中连接芯片与散热衬底的关键材料。覆铜陶瓷载板部分产品工艺门槛较高，全球掌握该工艺的公司数量不多，仅有少数企业如罗杰斯、贺利氏、Dowa、Denka及标的公司等能够实现大规模量产；而且，富乐华完成自研并量产了生产所需的陶瓷材料，打破部分产品原材料及高可靠性覆铜陶瓷载板依赖进口的局面，实现国产替代并反向出口海外，解决了功率半导体关键材料“卡脖子”难题，助力我国功率半导体产业链的完善与升级。

2. 未来泛半导体精密洗净市场的前景及公司市场份额变化，公司是否采取了主动定价策略来应对行业竞争？

答:2025年，受益于下游晶圆厂产能的持续释放及国产化进程的加速，国内泛半导体精密洗净市场整体呈现出稳健增长的态势，行业景气度维持在较高水平。

在此背景下，公司通过持续深化技术研发与市场拓展，进一步巩固了行业领先地位。

面对市场竞争，公司始终坚持价值导向，摒弃单纯的价格竞争，转而采取“技术增值+服务延伸”的差异化战略，通过提升服务附加值与拓展业务边界，有效增强了核心竞争力。

3. 年报显示2025年公司营业收入28.67亿元，同比增长7.46%。请明细拆分两大业务板块的收入构成：洗净及衍生增值相关销售收入约9.64亿元，覆铜陶瓷载板销售收入约18.9亿元。

答:2025年公司营业收入28.67亿元，其中：公司洗净服务覆盖国内主要泛半导体制造区域，针对精密洗净、增值服务、检测分析、半导体设备及其关键零部件维修等不同业务板块制定了适合市场需求的营销战略，继续开拓全球泛半导体领域客户，全年洗净及衍生增值相关销售收入约9.64亿元，增长23.46%。公司覆铜陶瓷载板销售领域针对DCB、AMB、DPC等不同陶瓷封装材料业务制定符合市场需求的营销战略，全年覆铜陶瓷载板销售收入约18.9亿元。

4. 公司将杭州之芯的ALN加热器翻新、静电吸盘制造等纳入“精密洗净衍生增值服务”范围，其毛利率高度可观，2025年全年这项零部件的翻新和新品制作的营收和利润贡献能否单独拆分？

答:杭州之芯半导体有限公司在2025年度经营表现良好,经审计的扣除非经常性损益后净利润为1,268.1万元,已超额完成年度业绩承诺。关于其具体营收数据,因未达到上市公司单独披露的标准,故未在本次年报中作进一步拆分,敬请谅解。

5. 年报中提到“半导体特殊材料洗净业务”和“特色半导体洗净业务”,指的是针对化合物半导体(GaN、SiC等)和硅基特殊材料等差异化材料的洗净服务吗?这些先进制程的特殊洗净工艺与主流的硅基晶圆洗净工艺有多大的技术迁移难度?

答:公司洗净相关主营业务涵盖的是泛半导体领域设备的精密洗净服务,未来富乐德仍将集中力量,进一步加强传统泛半导体洗净业务、特色半导体洗净业务、半导体特殊材料洗净业务等精密洗净服务。

6. 年报披露洗净事业群在研项目40余项,覆铜陶瓷基板方向在研项目50余项,总计数十个在研项目,请管理层详细说明这些研发项目中有多少直接面向下一代半导体制造工艺?

答:公司目前的研发项目高度聚焦于行业前沿技术,契合未来技术迭代方向,旨在持续巩固公司核心竞争力。

7. 年报显示毛利率28.36%,同比下降11.40个百分点,但净利率15.56%反而同比上升1.61个百分点。两个关键盈利指标方向背离,请解释主要原因。

答:公司产品分行业分别为:电子专用材料制造业和专业技术服务业,报告期内毛利率分别为21.06%和42.77%,分别较去年下降6.36%和增长3.01%。

8. 年报指出公司建立了一站式设备精密洗净及衍生增值服务,这覆盖了氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、机械抛光等几乎2/3集成电路生产工序的设备维护。这一综合优势在客户中已形成较高粘性,请量化说明老客户复购率和多产品交叉销售的比例提升情况。公司如何利用这种粘性将服务销售向周边增值服务、设备检测、核心零部件等领域延伸?

答:在精密洗净领域,公司与国内众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系。公司将洗净服务作为切入点,通过从“单一洗净”向“延伸增值服务”及“材料零部件”领域延伸,挖掘客户深度价值,推动业绩高质量增长。

9. 年报披露覆铜陶瓷载板的AMB工艺、DCB工艺及DPC工艺,请比较这三种技术路线在材料性能和应用于IGBT、SiC MOSFET、射频等

	<p>不同功率场景时的优势和局限性，谢谢！</p> <p>答：公司覆铜陶瓷载板事业群在覆铜陶瓷基板、功率半导体封装领域积累了较为丰富的经验，已成功开发AMB、DCB、DPC等适配不同应用场景的陶瓷金属化解决方案，Direct Bonding Copper，指采用直接覆铜工艺制作的覆铜陶瓷载板；Active Metal Brazing，指采用活性金属钎焊工艺制作的覆铜陶瓷载板；Direct Plating Copper，是直接镀铜工艺制作的覆铜陶瓷载板。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年05月12日</p>